

2018年2月8日

先端半導体パッケージ材料の需要増に対応し、現地生産体制を確立

## 中国・上海でモールドアンダーフィル対応半導体封止材の生産を開始

2018年1月からサンプル対応開始、2018年3月に本格稼働



パナソニック デバイスマテリアル上海有限公司  
(2018年2月 パナソニック)

パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社は、パナソニック デバイスマテリアル上海有限公司（以下PIDMSH）で、最先端半導体パッケージ向けモールドアンダーフィル[1] 対応半導体封止材（以下、MUF材料）の量産を2018年3月より開始、中国国内における同材料の需要増に対応します。

好調な国内市場と輸出の伸びに支えられ、中国メーカーによるスマートフォンをはじめとする携帯端末の増産傾向が続いています。そのため、半導体後工程受託メーカーや半導体メーカーは、中国での最先端半導体パッケージの生産を拡大しています。さらに、スマートフォンの高機能化による半導体パッケージの高密度実装化が進んでいることから、中国ではMUF材料の需要も拡大しています。当社は、お客様に対して、なお一層のスピーディーかつ効率的なサービスを提供するため、PIDMSHにおいて、新たに最先端半導体パッケージ用MUF材料の生産を開始します。

### 【当社のMUF材料】

- ・MUF材料は、[フリップチップ](#)[2] と半導体パッケージ基板との電気的接続部の保護と半導体パッケージ全体封止を一括成形する目的で使用されます。
  - ・当社の材料は次の特長を有しています。
1. フリップチップとパッケージ基板間の狭いギャップおよび狭い端子間への高い流動性・侵入性・充填性に優れ、信頼性を両立し、スマートフォンなどの用途に対応
  2. 低い熱収縮性と低弾性で、広い温度領域で基板や端子への追従性・低反り性・密着性に優れ、高い接続信頼性を実現
- ・今回の中国での生産開始に伴い、MUF材料の生産体制は、国内（三重県四日市）と合わせ2拠点になります。

## 【会社概要】

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 社名     | パナソニック デバイスマテリアル上海有限公司<br>Panasonic Industrial Devices Materials(Shanghai) Co, Ltd. |
| 所在地    | 148,Hauncheng North St., Comprehensive Industrial Development Zone, Shanghai, China |
| 設立     | 2001年10月                                                                            |
| 代表者    | 坂本 孝史(総経理)                                                                          |
| 主な生産品目 | 熱硬化性樹脂成形材料(車載電装部品用耐熱フェノール樹脂成形材料など)・エンジニアリングプラスチック・半導体封止材(*MUF材料は、2018年3月製造開始)       |

## 【備考】

本MUF材料は、2018年3月14日～3月16日までShanghai New International Expo Centerで開催される「SEMICON CHINA 2018」に出展します。

## 【商品のお問合せ先】

オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 電子材料事業部

[https://industrial.panasonic.com/cuif/jp/contact-us?field\\_contact\\_group=2201&field\\_contact\\_lineup=3240?ad=press20180208](https://industrial.panasonic.com/cuif/jp/contact-us?field_contact_group=2201&field_contact_lineup=3240?ad=press20180208)

## 【商品の詳細ページ】

<https://industrial.panasonic.com/jp/products/electronic-materials/semiconductor-encapsulation/ecom-super-fine/ecommu?ad=press20180208>

## 【用語説明】

[1] モールドアンダーフィル

フリップチップとパッケージ基板間の狭い隙間へ充填、及び電気接続端子(バンパなど)の封止保護と、パッケージ全体の封止を、専用の半導体封止材で一括成形する工法。

[2] フリップチップ

シリコンチップの回路面を下にして、パッケージ基板側に直接電気接続する工法。銅バンパやはんだボールなどを使用して接続される。従来の回路面を上にし、ワイヤボンディングでパッケージ端子と接続する工法との対比でこのように言われる。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。